

会 社 名 株式会社サムコインターナショナル研究所

登録銘柄 (店頭登録銘柄)

コード番号 6387

本社所在都道府県 京都府

(URL <http://www.samco.co.jp>)

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長兼経理部長
氏 名 山田史郎

TEL (075) 621-7841

決算取締役会開催日 平成 14 年 9 月 20 日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成 14 年 10 月 25 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 14 年 7 月期の業績 (平成 13 年 8 月 1 日～平成 14 年 7 月 31 日)

(1) 経営成績 (注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14 年 7 月期	2,966	(△27.3)	414	(△54.0)	433	(△52.2)
13 年 7 月期	4,078	(30.0)	902	(45.4)	907	(51.6)

	当 期 純 利 益		1 株 当 た り 当 期 純 利 益	潜在株式調整後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益	株 主 資 本 当 期 純 利 益 率	総 資 本 経 常 利 益 率	売 上 高 経 常 利 益 率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
14 年 7 月期	242	(△48.7)	49 54	—	5.4	5.9	14.6
13 年 7 月期	471	(44.1)	111 63	—	15.6	15.8	22.3

- (注) 1. 持分法投資損益 14 年 7 月期 一百万円 13 年 7 月期 一百万円
 2. 期中平均株式数 14 年 7 月期 4,889,680 株 13 年 7 月期 4,226,780 株
 3. 会計処理の方法の変更 無
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率
 5. 平成 14 年 7 月期の期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式控除後のものです。

(2) 配当状況

	1 株 当 た り 年 間 配 当 金			配 当 金 総 額 (年 間)	配 当 性 向	株 主 資 本 配 当 率
	中 間	期 末	円 銭			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
14 年 7 月期	12 50	—	12 50	61	25.2	1.3
13 年 7 月期	12 50	—	12 50	61	13.0	1.4

(注) 13 年 7 月期期末配当金の内訳 普通配当 10 円 00 銭、株式店頭上場記念配当 2 円 50 銭

(3) 財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株 主 資 本 比 率	1 株 当 た り 株 主 資 本
	百万円	百万円	%	円 銭
14 年 7 月期	7,053	4,592	65.1	939 29
13 年 7 月期	7,574	4,419	58.3	903 62

- (注) 1. 期末発行済株式数 14 年 7 月期 4,889,140 株 13 年 7 月期 4,890,890 株
 2. 期末自己株式数 14 年 7 月期 1,750 株 13 年 7 月期 670 株

(4) キャッシュ・フローの状況

	営 業 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー	現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
14 年 7 月期	386	△ 30	△ 446	1,620
13 年 7 月期	441	△2,502	2,881	1,717

2. 15 年 7 月期の業績予想 (平成 14 年 8 月 1 日～平成 15 年 7 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 年 間 配 当 金		
				中 間	期 末	円 銭
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	1,700	230	130	—	—	—
通 期	4,000	700	380	—	12 50	12 50

(参考) 1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 77 円 72 銭

※ 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる場合があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、添付書類の 5 ページを参照してください。

添付書類

1. 企業集団の状況

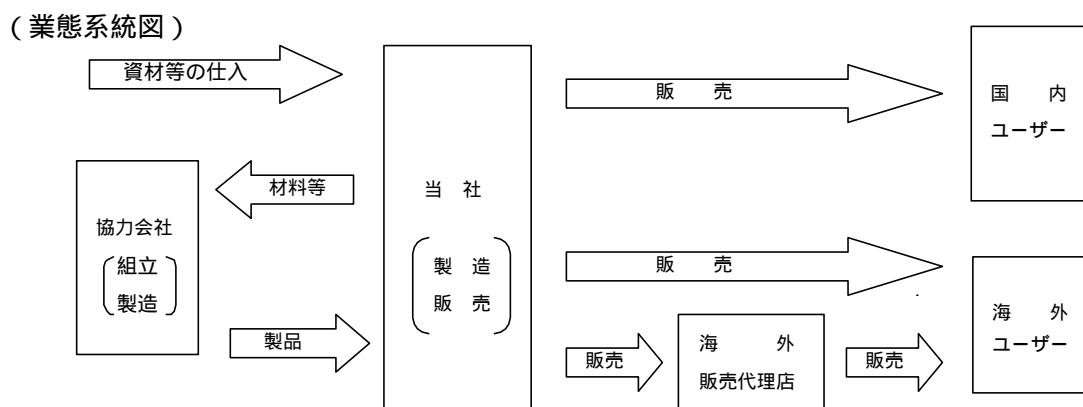
当社は、単独で事業を営んでおり、関係会社はありません。

当社は、半導体等電子部品製造装置メーカーで、薄膜形成・加工装置の製造及び販売を事業としております。薄膜形成・加工の方法には CVD法 (Chemical Vapor Deposition = 化学的気相成長法)

PVD法 (Physical Vapor Deposition = 物理的気相成長法) に大別されますが、当社は による方法が中心で、特にプラズマ利用を得意としております。プラズマCVD装置では、10nm~100µmまでの成膜が可能であります。(nm = ナノメートル: 10億分の1メートル µm = マイクロメートル: 百万分の1メートル)

当社の装置は、薄膜を形成するCVD装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基盤表面などをクリーニングする洗浄装置、その他装置等に区分されます。

当社の装置の製造に関しては、自社の設計企画により協力会社に製造を委託し、製品出荷の前に独自のプログラムソフトを入力し、仕様検査・出荷検査を経て販売しております。販売に関しては営業所を通じて行うと共に、海外については主に現地販売代理店に委託しており、これらの関係を図示すると以下の通りとなっております。



当社は装置等を以下の通りに区分しております。

(CVD装置)

反応性の気体を基盤の上に堆積させる装置で、一般に減圧下で半導体の絶縁膜、光学薄膜などを形成するために使われます。特に当社は発火性のガスを使用しない液体原料を活用したLS-CVD装置 (LS = Liquid Source) に特徴があり、比較的低温反応で速度が速く、均一性の良い成膜が可能であります。

(エッチング装置)

各種半導体の膜をはじめ微細加工が必要な材料を切削加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて切削していくものです。当社はICP (Inductive Coupled Plasma = 高密度プラズマ) を利用したエッチングに特徴があり、高速でかつ均一性の優れた加工が可能であります。

(洗浄装置)

当社の装置は溶液を使用しないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて洗浄するところに特徴があります。高速で自動運転が可能であるため、高集積化を要求される3次元実装などに必要とされております。

(その他装置)

高速熱処理装置など、上記装置には含まれない特注品であります。

(その他)

部品、保守メンテナンスなどであります。

2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社は『薄膜技術で世界の産業科学に貢献する』ことを経営理念とし、社員の創造性を重視し、常に独創的な薄膜技術を世界の市場に送る。直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値を目標とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。を経営方針に掲げ、事業を展開しております。

(2) 利益配分に関する基本方針

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けており、経営体質の強化と将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針

当社は、当社株式の流動性の向上と株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、単元株式数の見直し等株式投資単位の引き下げにつきましては、業績、市況等を勘案しつつ慎重に検討し、対処していく所存であります。

(4) 中期的な会社の経営戦略

当社はオプトエレクトロニクス分野に特化した市場戦略で、業容を拡大してまいりました。同分野は、高輝度、長寿命、省電力の特色のあるLED (Light Emitting Diode = 発光ダイオード) や薄型で長寿命の有機EL (Electro Luminescence) 並びに次世代光部品として有望なフォトニック結晶など、実用化に向けた研究開発が盛んに行われております。特にLEDは信号機、白色照明や各種バックライト用途、また有機ELは動画やカーナビ用途と、コストダウンと共に一層の成長が見込まれます。今後も、薄膜技術に関するソリューションを提供しながら、この分野における先駆的な企業として、産業の発展に貢献していきたいと考えております。

また、生産技術研究棟の完成により装置の生産能力が年間120億円と大幅に向上することから、今後は販売力の強化を最重点戦略と位置付けております。国内販売拠点の充実と中国市場への販売力拡大に全力を傾ける所存であります。

(5) 対処すべき課題

現状の認識について

半導体等電子部品製造装置業界は、IT (情報通信技術) 不況からの回復の途上であるものの、先行き不透明な状況であります。当社は所謂シリコンサイクルの影響が少ないオプトエレクトロニクス分野に特化してきておりますが、今後この市場も拡大するにつれて企業間競争が激しくなってくると認識しております。

当面の対処すべき課題の内容

以上の現状認識の下、当社は、引き続きオプトエレクトロニクス分野に経営資源を集中するとともに、薄膜技術の研究開発分野では常にトップランナーとして、また装置販売ではソリューション提供企業として、市場での存在価値を高めながら、当面は量産用装置の販売体制構築が課題であると考えております。

また、中期的にはペットボトル・コーティング技術の商品化などの環境事業や燃料電池などのエネルギー事業やバイオ関連事業などを課題として取り組んでいきたいと考えております。

対処方針

当社は、今までの成長過程の中では自社の研究活動や人材だけではなく、むしろ積極的に外部の経営資源や人材を活用してきた実績があります。今後ともこの方針に変更はなく、業容が拡大する中で、有機的かつ効率的に外部組織と連携を深め、人的ネットワークを一層活用していきたいと考えております。

具体的な取組状況等

営業力の強化については、中途採用を含めた営業人材の強化、九州地区と関東地区等国内営業拠点の拡充、システム活用を中心とした販売ノウハウの蓄積及び中国市場開拓で提携する専門商社との連携を深めていきたいと考えております。また、新事業については業務提携等を含め費用対効果を充分考慮しながら積極的に展開していきたいと考えております。

3. 経営成績及び財政状態

(1) 当期の概況

当期のわが国経済は下期に入り回復の兆しが現れたものの、総じて個人消費の低迷、民間設備投資の抑制など、厳しい状況で推移してまいりました。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界も、世界的なIT(情報技術)不況の下、前期決算は業績不振、事業環境悪化で、減収減益とした企業が多く、苦戦を強いられた時期でありました。

こうした環境の中において、当社は一貫してオプトエレクトロニクス分野に注力し、グローバルな研究体制の下での積極的な研究開発活動と営業活動を展開してまいりました。特に販売面では、仙台出張所の開設、ナノテク関連分野への積極的アプローチを実施し、開発面では低価格・自動運転可能なエッチング装置や新表面処理プロセス技術を搭載した洗浄装置等を発表し、また製造面ではSCR15(Samco Cost Reduction 15)にて製造原価の15%低減運動を展開してまいりました。一方設備投資面では、平成13年に購入した新社屋の改装に着手し、新しく生産技術研究棟(年間生産能力120億円)として完成させました。

以上のような活動をしてまいりましたものの、当期の業績は低迷するIT需要の影響を受け、売上高は2,966百万円(前期比27.3%減)、経常利益は433百万円(前期比52.2%減)、当期純利益は242百万円(前期比48.7%減)の結果となりました。なお主な品目別の売上高は次の通りであります。

(CVD装置)

前期に受注した企業向け量産機としての光導波路用成膜装置及び大学・官庁向けの研究開発用装置が上半期、堅調に推移したものの、下半期は光通信市場向け量産用装置が伸び悩み、僅かに研究開発用装置を企業や大学に出荷したにとどまり、売上高は999百万円(前期比15.0%減)となりました。

(エッチング装置)

オプトエレクトロニクス分野に対する研究開発用が堅調に推移したものの、量産用装置がLED用途向けに出荷したにとどまり、期待した通信用途向けが全く振るわなかったことと、当社の規格品であるRIE-10NRが表示・磁気記録デバイス分野を中心に健闘したものの、戦略装置であるICP装置が今一步伸びなかったことにより、売上高は1,263百万円(前期比32.1%減)となりました。

(洗浄装置)

半導体後工程用の表面処理需要が平成14年に入り回復基調に向かい始めたのを契機に、当社においても2月頃より受注が増加し、下半期に限れば前期実績に近い結果を残すことが出来たものの、上半期の需要低迷が大きく影響し、結果売上高は354百万円(前期比35.4%減)となりました。

(その他装置)

高速熱処理装置などの特殊な装置を出荷したにとどまり、売上高は48百万円(前期比67.9%減)となりました。

(その他)

部品やメンテナンスが比較的安定的に推移しましたが、今期の装置売上高の減少が影響し、売上高は299百万円(前期比12.3%減)となりました。

(品目別売上高)

品 目	売上高(千円)	構成比(%)	前期比増減(%)
CVD装置	999,757	33.7	15.0
エッチング装置	1,263,952	42.6	32.1
洗浄装置	354,345	12.0	35.4
その他装置	48,200	1.6	67.9
その他	299,798	10.1	12.3
合 計	2,966,054	100.0	27.3

なお、当社は装置により製造される半導体等電子部品をその用途により、LED・半導体レーザー・DWDM(Dense Wavelength Division Multiplex=高密度波長多重伝送)関連のオプトエレクトロニクス分野(光エレクトロニクス分野)、各種センサー・水晶デバイス、高周波デバイスなどの電子部品分野、半導体パッケージ技術や混載技術などの実装・表面処理分野、有機EL、磁気ヘッドなどの表示・磁気記録分野、部品・メンテナンス、その他分野に分類しております。

用途別売上構成は次の通りであります。